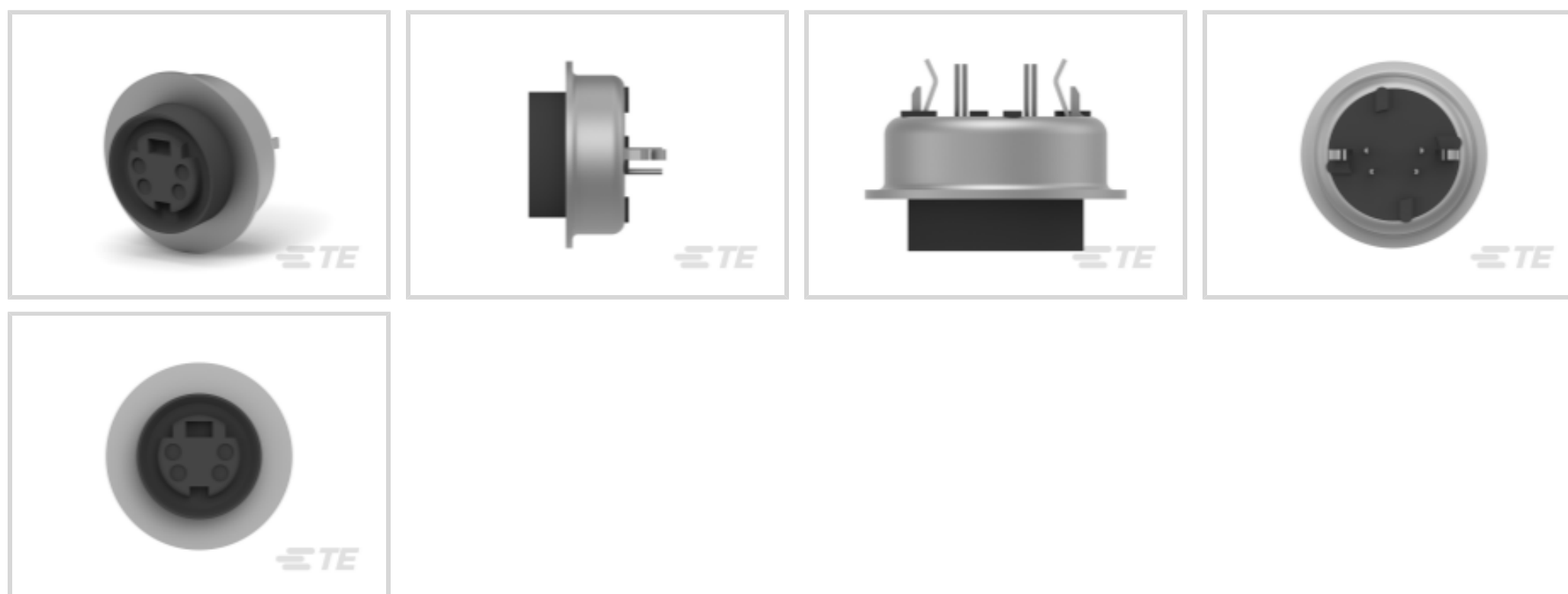


连接器 > 电路连接器 > DIN 连接器



圆形 DIN 连接器类型: **迷你 DIN**

连接器系统: **线到板**

位数: **4**

连接器端子负载状态: **满载**

接合对准类型: **极化, 极化**

产品特性

产品类型特性

圆形 DIN 连接器类型	迷你 DIN
连接器系统	线到板
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

PCB 安装方向	垂直
位数	4
连接器端子负载状态	满载

电气特征

工作电压	30 VAC
------	--------

主体特性

面板接地特定类型	无
屏蔽电镀厚度	3.81 μm , 5.08 μm [150 μin][200 μin]
屏蔽底板材料	镍
屏蔽电镀涂层	亮光
屏蔽底板厚度	1.27 μm [50 μin]
屏蔽电镀材料	镍打底镀锡

屏蔽材料	黄铜
------	----

主要产品颜色	黑色
--------	----

接触件特性

PCB 端子端接区域电镀材料厚度	2.54 μm , 3.81 μm [100 μin][150 μin]
------------------	--

端子布局	交错
------	----

端子底板材料厚度	1.27 μm [50 μin]
----------	---

端子接合区域电镀材料厚度	.76 μm [30 μin]
--------------	--

端子接触部电镀材料	金
-----------	---

PCB 端子端接区域电镀材料表面涂层	哑光
--------------------	----

端子形状和构造	音叉
---------	----

端子底板材料	镍
--------	---

PCB 端子端接区域电镀材料	锡
----------------	---

端子基材	磷青铜
------	-----

端子额定电流 (最大值)	.5 A
--------------	------

端接特性

端接柱体和尾部长度的	3.18 mm[.125 in]
------------	------------------

PCB 端接方法	通孔 - 焊接
----------	---------

机械附件

PCB 安装对准类型	压紧
------------	----

接合对准	带有
------	----

PCB 安装对准	带有
----------	----

面板安装特性	带有
--------	----

面板安装特性类型	螺母
----------	----

接合对准类型	极化, 极化
--------	--------

PCB 安装固定	带有
----------	----

PCB 安装固定类型	弯脚
------------	----

连接器安装类型	板安装
---------	-----

壳体特性

外壳材料	热塑性
------	-----

中心线 (间距)	6.5 mm[.26 in]
----------	----------------

尺寸

连接器高度	13.08 mm[.51 in]
-------	------------------

PCB 厚度 (建议)	2.68 mm[.11 in]
-------------	-----------------

产品宽度	17.78 mm[.7 in]
------	-----------------

产品长度	22.61 mm[.89 in]
------	------------------

使用环境

工作温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

屏蔽	是
----	---

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装数量	60
------	----

封装方法	Tray
------	------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
--------------------	----

欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
-------------------	----

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法 (China RoHS 2, 工业和信息化部携七部委2016年第32号令)	没有超出阈值的受限材料
--	-------------

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240) SVHC候选清单的声明更新至: 2022年6月 (224) 不含REACH SVHC
-----------------------------	---

卤素含量	低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
------	---

焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C
--------	---------------

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

客户还购买了



TE 产品编号5750678-1
09 RCPT SP/FMS (RET SL)



TE 产品编号1-1622820-8
3520 1R0 5%



TE 产品编号1-1337481-0
SMB R/A PCB Skt 50Ohm Gold Plt



TE 产品编号2-1437565-7
FSM2JSMA=SMT,TACTILE,PB SWITCH



TE 产品编号5103308-1
A/L LOW PRO HDR 10P VERT BLACK



TE 产品编号1-1571983-1
GDH08STR04=DIP SWITCH



TE 产品编号1734327-2
MINI USB, TYPE A, R/A, SMT



TE 产品编号4-1825059-2
ADF08STTR04=DIP S,FLUSH,SMT-GW



TE 产品编号292304-1
STD USB TYPE B, R/A, T/H



TE 产品编号6-1393238-2
RTD14012

文档

产品图纸

Mini DIN, 4 pos, Vertical, Shield

英文版本

CAD 文件

下载查看

[ENG_CVM_CVM_5750317-2_O.2d_dxf.zip](#)

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_5750317-2_O.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_5750317-2_O.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。



[产品规格](#)

[应用规格](#)

[英文版本](#)